

国泰海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：芯联集成
保荐代表人姓名：徐亦潇 宋轩宇	被保荐公司代码：688469

重大事项提示

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）上市时未盈利且尚未实现盈利，2024 年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-140,956.02 万元，仍为负值。

公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU 等主要技术平台，面向车载、人工智能（AI）、高端消费、工业控制等领域，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工方案。

截至报告期末，公司尚未实现盈利，主要系公司属于资金密集型及技术密集型半导体行业，需要大额的固定资产投资及持续的研发投入以保持产品的技术领先，报告期内，公司研发投入、固定资产折旧金额较高，影响了公司的净利润表现。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2024 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）21.46 亿元，同比增长 131%。目前公司已成长为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量。公司坚持技术+市场双轮驱动，打造全球领先的数模混合系统代工平台。2025 年，公司将紧抓 AI 智能时代机遇，持续技术创新，在模拟 IC、功率模块、以及 SiC MOSFET、MEMS 等新增长点的带动下，迈入新一轮高增长阶段。

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548 号）批复，芯联集成电

路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 194,580.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,160.20 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,078,341.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 5 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下：

一、2024 年年度保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。

项目	工作内容
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。

项目	工作内容
<p>日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	
<p>13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司不存在控股股东、实际控制人，上市公司或其董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。</p>
<p>14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司不存在控股股东、实际控制人，上市公司不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
<p>15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事項。</p>

项 目	工作内容
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。保荐机构根据相关法规要求，制定上市公司现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，开展现场检查。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
<p>22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。</p>
<p>25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
26、保荐机构发表核查意见情况。	<p>2024 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2024 年 1 月 9 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的核查意见》。</p> <p>2024 年 1 月 9 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。</p> <p>2024 年 3 月 22 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见》。</p> <p>2024 年 3 月 22 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。</p> <p>2024 年 4 月 29 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。</p> <p>2024 年 6 月 4 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见》。</p> <p>2024 年 10 月 25 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p>
27、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	不适用

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

国泰海通持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）尚未盈利的风险

公司所处的晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业，在建设发展期需要大额的资产投入及持续的研发投入以保持技术领先和扩大生产规模。报告期内，公司整体仍处于产能爬坡期和全折旧期，规模效应尚未完全显现，公司产品结构尚未达到最优状态，因此公司尚未盈利。公司通过优化产品结构、提升公司的产品竞争力，改善盈利能力。同时，持续引进技术研发、生产制造等各领域专业技术人员，扩充人才队伍，不断提升技术开发和生产管理效率。在经营规模快速增长的同时，公司的市场渗透率、合作伙伴的多样性、团队的技术水平等都在稳步提升，为公司盈利能力的改善构筑了坚实的基础。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

因市场需求的增长及公司产能的不断攀升，公司产品产出和销售量均逐年提升。但是，如在后续的扩产过程中，出现宏观环境恶化、行业周期导致下游需求不足，亦或公司未能按计划推动客户验证及客户开发进度，可能导致公司未来收入出现下滑的风险。

（三）核心竞争力风险

1、产品研发与技术迭代风险

半导体产业技术及产品迭代速度较快。公司的发展在很大程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品。为保证公司产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，公司在研发方面投入大量资金与人力资源。

由于半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快、研发周期长、资金投入大的风险，如果公司的技术与工艺未能跟上竞争对手，新技术、新工艺的升级受阻、下游客户的需求发生难以预期的变化，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。

2、公司规模扩张与核心技术人员流失带来的管理风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着半导体行业对专业技术人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

公司资产规模、业务规模和员工数量均快速增长的同时，公司各项业务将会进一步快速扩张。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司未能及时有效应对公司规模扩张带来的管理问题，可能会面临一定的管理风险。

（四）经营风险

1、行业周期风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于国际关系等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

2、主要原材料市场集中风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、光刻胶、化学品、气体、靶材、引线框等等。原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如大尺寸硅片、光刻胶等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商集中度也相对较高。同时，由于其他不可抗力等

因素的影响，原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够原材料供应的状况，公司的正常生产经营可能会受到影响。

3、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素之一。公司的专有技术、商业机密、专利或集成电路布图设计存在被盗用或不当使用的风险，也不排除现有知识产权被监管机构宣告无效或撤销，以及和竞争对手产生其他知识产权纠纷，这些情况都会对公司的业务开展产生不利影响。同时，公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，从而影响国际化业务的开展。

（五）财务风险

1、信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，主要客户及供应商均为国内外头部公司，规模较大，信用水平较高。但由于公司规模不断扩大，与公司交易的第三方众多，未来如果部分客户或者供应商的经营情况发生不利变化，可能会面临应收账款回款或采购交付的信用风险。

2、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀等均会对汇率造成一定的影响。公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，但公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率产生的影响程度，因此，人民币汇率的波动可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

（六）行业风险

近年来，随着国内半导体市场需求的不断扩大，半导体行业呈现快速扩张的趋势。但由于国内行业整体发展历程较短，市场需求仍在平衡中，国内半导体行业的生态管理仍需持续推进。目前，半导体行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，但若未来相关部门出台的法律法规、

行业标准、产业政策、出口政策等对公司产品及业务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。

（七）宏观环境风险

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。由于半导体行业受下游及终端应用市场需求波动的周期性影响，如未来宏观经济疲软，终端应用市场的需求尤其是增量需求下滑，客户将会减少产品的采购，行业将面临一定的波动风险。

随着国际贸易摩擦加剧，美国的“对等关税”政策，可能使公司面临原材料、零备件等生产资料供应紧张的风险，同时影响美国及相关的市场需求。在采购方面，公司在经营范围的成熟工艺已经实现多元化供应链安全，对于少数向美国供应商采购的设备和材料，主要是为了维护头部供应商关系存在。公司将继续推进多元化供应链的验证和导入，或与美国头部供应商协商，从其坐落在其他国家的工厂进行采购。在销售方面，公司直接客户主要集中在国内市场以及与欧洲、日本等地区，直接出口美国的金额非常小，对公司无显著影响。

四、重大违规事项

2024年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
营业收入	650,909.08	532,448.28	22.25	460,633.77
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	627,608.29	491,073.95	27.80	395,842.83
归属于上市公司股东的净利 润	-96,215.96	-195,833.18	减亏 50.87%	-108,843.26
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-140,956.02	-226,168.58	减亏 37.68%	-140,305.32
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	214,571.36	92,541.68	131.86	80,974.18

经营活动产生的现金流量净额	190,262.04	261,430.16	-27.22	133,428.17
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,232,101.39	1,248,307.47	-1.30	344,376.39
总资产	3,420,272.38	3,157,036.64	8.34	2,585,955.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)	2022 年
毛利率 (%)	1.03	-6.81	不适用	-0.23
净利率 (%)	-34.51	-55.24	不适用	-34.63
息税折旧摊销前利润率 (%)	32.96	17.38	增加 15.58 个百分点	17.58
基本每股收益 (元 / 股)	-0.14	-0.32	不适用	-0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.14	-0.32	不适用	-0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.20	-0.37	不适用	-0.28
加权平均净资产收益率 (%)	-7.97	-22.44	增加 14.47 个百分点	-27.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.67	-25.91	增加 14.24 个百分点	-35.24
研发投入占营业收入的比例 (%)	28.30	28.72	减少 0.42 个百分点	18.22

(三) 公司主要会计数据和财务指标的说明

营业收入变动的主要原因：系报告期内公司销售规模扩大，客户不断拓展。公司晶圆代工收入同比增加 11.23 亿元，同比增长 25.11%；模组封装收入实现 6.02 亿元，同比增长 54.54%。其中车规级功率模组全面覆盖中国主流车厂及系统厂商，高功率 IGBT/SiC 功率模组封装技术已达国际领先水平，2024 年实现收入同比增长 106%。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动的主要原因：系报告期公司销售规模扩大，客户不断拓展，产品结构持续优化，同时通过供应链管控、精益生产管理等措施实现降本增效，提升了公司整体盈利能力。

六、核心竞争力的变化情况

（一）稀缺的一站式集成代工制造能力

公司为客户提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式芯片和模组的代工服务。一站式系统代工服务通过高效整合制造端与封测端的生产资源，提升了公司的运营管理效率，同时切实解决了当前芯片代工制造中的诸多痛点，有效提升了产品的安全性与可靠性，大幅缩短了产品从制造到封装测试的周期，确保产品交付的准时性，也让终端客户的责任划分更加清晰，显著降低客户的显性和隐性成本。

同时，借助一站式系统代工服务的模式，公司能不断拓宽客户种类。除传统的设计公司外，公司也与诸多终端主机厂和系统公司进行了深度合作，实现了丰富、有纵深的客户布局。

（二）多产业核心芯片及模组的业务生态布局

公司坚持自主研发，从功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向出发，持续研发应用于 AI、新能源汽车、工业控制、高端消费领域所需要的产品上先进工艺及技术，为客户提供多样化的晶圆代工和封装测试等系统方案。

公司不断利用自身技术优势，持续开发产品附加值较高的技术平台并加大应用推广。报告期内，公司加强 AI 新兴应用领域的研发和工艺平台开发，开发应用于 AI 服务器电源、数据中心、机器人等相关产品，并已获得重大突破。

同时，在模组方面，公司产品系列完整，广泛应用于新能源汽车、光伏风电、智能电网及其他变频领域，和国内外先进终端紧密结合，技术水平不断提升。随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代更新，公司产品结构不断升级，产品种类快速拓展，业务生态模式也更加灵活。

（三）全生命周期的供应商管理体系及多元化的供应链建设

公司制定并实施了符合车规级标准的供应商管理准入体系，构建了供应商绩效评估体系，从而在整个供应商生命周期内，包括质量改进、市场份额分配、以及升降级制度等方面，实现了全面的供应商管理。

公司秉持着对供应链多元化和国内外双循环机制构建的高度重视，已在关键业务领域与国内外主流供应商建立了紧密的战略合作关系，共同应对市场变化和策略调整，确保公司能够长期稳健发展。公司通过不断推进直接材料和关键零部件的多元化项目，其多元化比例已处于国内领先水平。此外，通过与核心战略供应商的深度协作，公司获得了高优先级的服务和具有成本竞争力的长期合作方案，为公司的持续发展提供了坚实保障。

（四）技术研发水平业内领先

公司坚持自主研发的路线，重视研发体系建设，在“市场+技术”双轮驱动的发展战略下，持续研发先进的工艺及技术，提供多样化的晶圆代工和封装测试等系统代工方案。

公司汇聚了一支技术实力深厚、经验丰富的研发团队，其中团队核心成员均是在行业内深耕数十年的资深研发技术人员，其专业能力和创新能力，为公司带来了源源不断的技术突破和创新发展，成为了公司持续进步和行业领先的重要保证。

公司持续保持高额的研发投入，积极推动科技创新，全力促进成果转化。报告期内，公司研发投入 18.42 亿元，占营业收入的 28.30%。公司成立至今，保持每 1-2 年进入一个新赛道，同时仅用 3-4 年时间做到技术业界领先，6-7 年跻身行业头部。

（五）拥有数字化、车规级智慧工厂

公司是目前国内少数提供车规级芯片代工的企业之一。车规级芯片面临着复杂的使用环境和应用工况，对产品的安全性、可靠性、外部环境兼容性、使用寿命等方面的要求相比工业级和消费级芯片更为严格。因此，车规级芯片制造门槛高，产业化周期长，极其考验代工厂的技术研发能力和质量管理能力。公司的车规级智慧工厂在提高生产效率、保证产品质量以及降低运营成本方面发挥着重要的作用。

公司已攻克各种可靠性、安全性的技术难题，建立了从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系，通过了 ISO9001（质量管理体系）、IATF16949（汽

车质量管理体系)等一系列国际质量管理体系认证,以及 ISO26262(道路车辆功能安全体系)体系认证。公司的车规级工厂遵循严格的质量管理体系标准,并引入 AI 辅助缺陷判断等先进的质量管理工具和方法进一步提升质量水平,预防潜在的质量风险。通过深化全流程质量管理,使产品质量具有卓越的稳定性和可靠性,从而获得更多客户定点。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化情况

2024 年度,公司研发支出情况如下:

单位:万元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	184,194.82	152,917.89	20.45
资本化研发投入	0	0	-
研发投入合计	184,194.82	152,917.89	20.45
研发投入总额占营业收入比例(%)	28.30	28.72	减少 0.42 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	

2024 年,公司坚持高水平的技术研发投入,持续引进高端技术人才,配备国际先进技术资源,不仅在晶圆制造工艺方面进行大力研发,并向模组封装领域进行延伸,助力芯片行业的集成化发展,成功推出大量新产品,获得多个重大客户定点。

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	180	57	729	199
实用新型专利	73	60	272	209
外观设计专利	2	1	8	7
软件著作权	0	0	0	0
其他	4	0	16	1
合计	259	118	1025	416

(二) 在研项目情况

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	灌封车载模块技术研发	1200VIGBT 灌封模块动静态/出流性能达标, 客户测试完成	1200VIGBT 灌封模块实现自主研发	国内领先	新能源汽车主驱逆变器
2	灌封工业光伏模块技术研发	建立相对完整的风光储产品平台体系结构 (HF5/ED3/62mm/HE6), 并完成头部客户送样定点	研发风光储模块, 实现规模量产及产品平台搭建	国内领先	光伏/储能逆变器
3	小功率 TO 封装技术研发	已完成在风光储/家电/车载/变频领域多家客户送样, 形成完整的应用领域体系	实现平台量产, 对应终端领域: 风光储/家电/车载/变频领域	国内领先	风光储/家电/车载/变频领域
4	IPM (SSC) 封装工程技术研发	完成 DIP/SSOP54 系列多规格产品开发, 并送样, 客户验证中	性能达到国际同类厂商水平, 提供高质量的量产平台	国内领先	应用于白色家电变频核心新平台, 填补家电领域智能功率器件(含 HVIC/LVIC)空白
5	12 英寸射频 SOI 器件技术研发	平台工艺开发完成, 可靠性验证完成, MPW 客户产品导入并完成送样	完成射频前端器件如开关, 低噪放大器 etc SOI 芯片工艺平台技术, 提供射频前端器件晶圆代工服务	国内领先	产品覆盖 4G、5G 等射频前端领域
6	MCU 平台技术研发	1.180 纳米 BCD 嵌入式闪存工艺平台多个客户导入; 2.55 纳米嵌入式闪存工艺平台开始客户导入	提供低功耗、低成本、高性能及高可靠性的 MCU 工艺平台	国际领先	平台广泛应用于工业级和车规级电子类产品
7	BCD 工艺技术研发	SOIBCD 和 55 纳米 BCD 平台发布, 产品导入验证中	开发出 20V~150V 的中低压 BCD 工艺平台(工业类和车规类), 性能达到国内领先水平, 实现规模量产	国内领先	用于消费电子、工业电源, 汽车等领域
8	用于三维感知的 MEMS 激光技术研发	数通 VCSEL, 已完成工艺开发并送样	建立专用生产线, 完成 GaAs 基光电传感器代工平台	国内先进	产品应用于消费类, 车载类和数通类的光电传感器领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
9	SiCMOSFET 技术研发	8 英寸 SiC 平台完成全系列产品参数及可靠性认定，进入小批量阶段，下一代器件平台研发中	完成 8 英寸量产，性能达到国际同类厂商水平，提供高质量的量产平台	国内领先，对齐国际水平	应用于工控、乘用车的高可靠性、高性能 SiCMOSFET 芯片
10	高性能 MOSFET 技术研发	下一代高性能 MOSFET 平台研发推进中	性能达到国际同类厂商水平，提供规模化的代工平台	国内领先	用于充电桩、高端服务器电源、光伏电源
合计	/	/	/	/	/

注：上述项目为公司截至报告期末的主要在研项目。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	1,107,160.20
减：保荐及承销费用（不含税）	25,569.80
实际收到募集资金金额	1,081,590.40
减：截止 2024 年 12 月 31 日投入募集资金总额	1,044,555.29
其中：募投项目前期投入置换金额	166,000.00
募集资金置换已支付的发行费用	358.98
募集资金到账后投入募投项目金额	741,138.43
支付其他发行费用	2,618.87
节余募集资金永久补充流动资金*	7,439.01
尚未到期的结构性存款金额	127,000.00
加：截止 2024 年 12 月 31 日利息收入	9,991.07
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	47,026.18

注：截止2024年12月31日，公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用,合计270.85万元，公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。具体内容详见2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至报告期末，公司第一大股东越城基金持股比例为 16.32%，第二大股东中芯控股持股比例为 14.08%，任一股东均无法控制股东大会的决议或对股东大会决议产生决定性影响；公司董事会由 9 名董事组成，其中越城基金提名 2 名董事，中芯控股提名 2 名董事，任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

截至 2024 年 12 月 31 日，芯联集成董事、监事和高级管理人员所持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	年末持股数
1	赵奇	董事长、董事、总经理、核心技术人员	0
2	王劲松	董事	0
3	叶海木	董事	0
4	林东华	董事	0
5	刘焯杰	董事、执行副总经理、核心技术人员	0
6	陈琳	独立董事	0
7	李生校	独立董事	0
8	李旺荣	独立董事	0
9	王保平	独立董事	0
10	王永	监事会主席	0
11	黄少波	监事	0
12	何新文	监事	0
13	陈俊安	职工代表监事	0
14	彭梦琴	职工代表监事	0
15	王伟	财务负责人、董事会秘书（离任）	0
16	肖方	资深副总经理、核心技术人员	0
17	张霞	副总经理	0
18	严飞	副总经理	0
19	张毅	董事会秘书	0
20	单伟中	核心技术人员、执行总监	0
21	丁国兴	董事长（离任）	0

序号	姓名	职务	年末持股数
22	汤天申	董事（离任）	0
23	李序武	独立董事（离任）	0
24	史习民	独立董事（离任）	0
25	周淑斌	职工代表监事（离任）	0

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

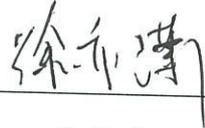
十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



徐亦潇



宋轩宇



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月30日